

【TSIA 新聞稿 115.10.01】

2026 TSIA 30週年會 將於10月29日假新竹國賓飯店盛大舉行！

《~承先啟後 再締輝煌~》

1996 年在眾多產業先進的共同倡議與推動下，台灣半導體產業協會(TSIA)正式成立，三十年來，TSIA 與會員並肩同行，致力於扮演產業與政府之間重要溝通橋梁，促進產業合作並積極參與國際協商與交流，凝聚產業共識，在競合之間創造價值，提升整體競爭力。

本次年會特別邀請創會理事長史欽泰董事長蒞臨主講「從一甲子薪火到三十而立 - 台灣半導體的學習與創新之路」，帶領大家回顧半導體產業筚路藍縷的歷程到今日的成就。並邀請國立陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長 孫元成副校長擔任論壇主持人，以「如何鞏固台灣優勢，建立更具韌性的 EcoSystem」為題進行交流，精彩可期。

會中同時將舉行「2026 TSIA 半導體獎暨半導體設備創新獎」頒獎，鼓勵年輕學子積極投入半導體相關研發與創新。

TSIA 誠摯邀請您一同回顧協會三十年來努力的歷程與成果，也將秉持初衷，承先啟後、再締輝煌，邁向下一個嶄新的里程碑。

2026 TSIA 年會活動網站< <https://www.tsia.org.tw/annual2026/index.html>>

關於 TSIA：

台灣半導體產業協會成立於 1996 年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA 會員涵蓋 IC 設計、晶圓製造、封裝測試、設備及材料等半導體產業鏈主要環節，會員逾 220 家，匯聚臺灣各領域具代表性的半導體業者。會員組成完整且多元，廣泛串聯臺灣半導體產業上下游，充分展現臺灣半導體產業深厚的在地產業基礎與完整的產業聚落。更多資訊，請上 www.tsia.org.tw 查詢。

新聞聯絡人：

台灣半導體產業協會 | 石英堂協理 [TEL: 03-591-7092](tel:03-591-7092) | email: celia@tsia.org.tw